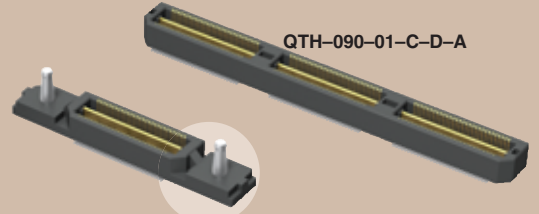


QTH-060-07-F-D-A



QTH-090-01-C-D-A

QTH-030-01-L-D-A-RT1

高速接地插头

技术规格

如需了解完整技术规格以及所建议的 PCB 布局, 请浏览 www.samtec.com/QTH

绝缘体材料:

液晶

聚合物

端子材料:

磷青铜

电镀:

在 50μ" (1.27μm)

的镍上镀金或锡

额定电流:

触点: 30°C 温升时为 1.0A

接地板: 30°C 温升时为 7.8A

工作温度范围:

-55°C 至 +125°C

额定电压:

125 VAC (5mm 堆叠高度)

最大次数:

100

拔出力 (-RT1 选项): -RT1 选

择增加

拔出力多达 50%

符合 RoHS 规范要求:

是

加工:

可无铅焊接:

是

SMT 引线共面性:

(0,10mm) .004" 最大 (030-060)

(0,15mm) .006" 最大 (090-120)

电路板相叠:

有关每块电路板需要两个连接器

或 4 列或更多列的应用,

请联系 ipg@samtec.com

特殊应用选项

- 14mm、15mm、22mm 和 30mm 堆叠高度 (小心: 有些自动放置/插入机械可能有元件高度限制。请参考机械技术规格。)
- 30μ" (0,76μm) 的金 (为数据速率线缆连接应用指定 -H 电镀。)
- 边缘安装和导柱
- 每排 150 个位置 请致电 Samtec。

电路板配接: QSH

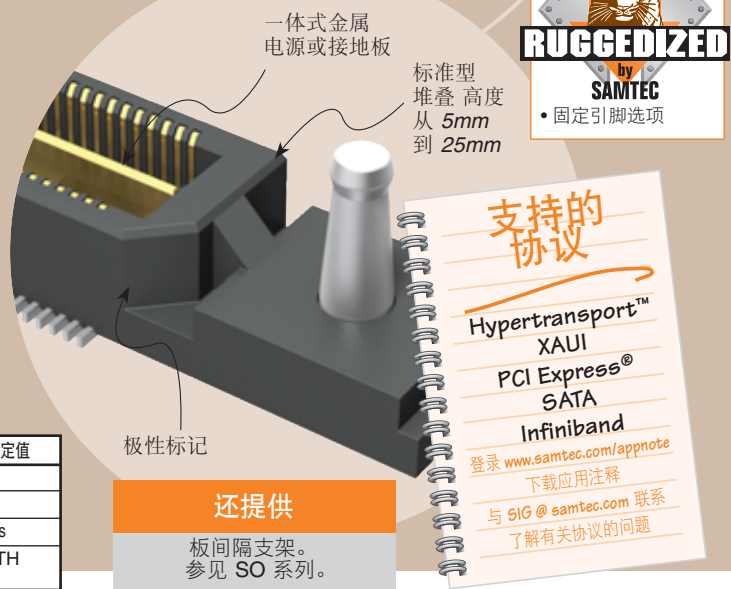
缆线配接: HFHM2, HQCD, HQDP

(参见特定应用的注释)



| 5mm 堆叠高度 | 类型 | 在 3dB 插入损耗的额定值 |
|----------|-----|-------------------|
| 单端信号 | -D | 9 GHz / 18 Gbps |
| 差分对信号 | -D | 8 GHz / 16 Gbps |
| 差分对信号 | -DP | 9.5 GHz / 19 Gbps |

如需完整测试数据, 请浏览 www.samtec.com/QTH 或联系 sig@samtec.com



还提供

板间隔离架。参见 SO 系列。

QTH - 每排引脚数对数 - 引线式样 - 电镀选项 - 类型 - A - 其他选项

-030, -060, -090, -120 (每列总共 60 个引脚 = -D)

-020, -040, -060, -080 (每列 20 对 = -D-DP)

从图表中指定引线式样

-F = 信号引脚和接地板上镀金膜, 焊尾镀雾锡

-L = 在信号引脚和接地板上镀 10μ" (0,25μm) 的金, 焊尾镀雾锡

-C* = 可选电镀 在触点区域的信号引脚上镀 150μ" (3,81μm) 的金, 之上最少镀 50μ" (1,27μm) 的金, 在触点区域的接地板上镀 50μ" (1,27μm) 的金, 之上最少镀 10μ" (0,25μm) 的金, 在所有焊尾上镀最少 50μ" (1,27μm) 镍, 之上镀雾锡

-D = 单端

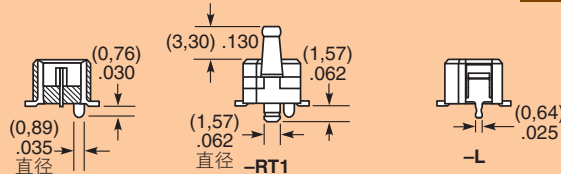
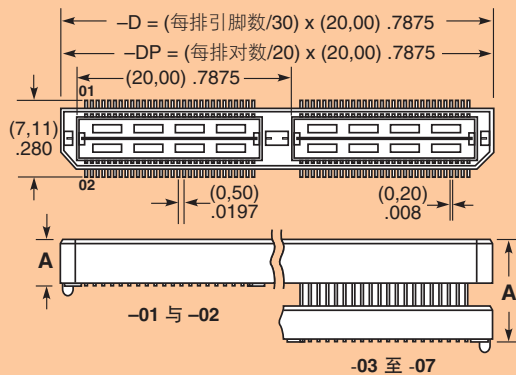
-D-DP = 差分对 (仅限 -01)

-K = (7,00mm) .275" 直径聚乙烯酰胺膜取放垫 (不提供 -05 与 -07 引线式样)

-TR = 卷带封装 (-090 最大位置数)

-RT1 = 固定选择 (仅限 -01 引线式样和 -090 最大位置数)

-L = 锁紧选项 (适用于 -01) (对 -RT1 不提供)



| QTH 引线式样 | A | 与 QSH 的高度* |
|----------|--------------|--------------|
| -01 | (4,27) .168 | (5,00) .197 |
| -02 | (7,26) .286 | (8,00) .315 |
| -03 | (10,27) .404 | (11,00) .433 |
| -04 | (15,25) .600 | (16,00) .630 |
| -05 | (18,26) .718 | (19,00) .748 |
| -07 | (24,24) .954 | (25,00) .984 |

*加工条件将影响配接高度。

*注: -C 电镀通过 10 年 MFG 测试

注: 有些长度、式样和选项为非标准型, 不可退换。